



Smart Eyes Smarter Industry

LighTek

龙瞳智能

-Trigis 系列

TSV光学测量模组

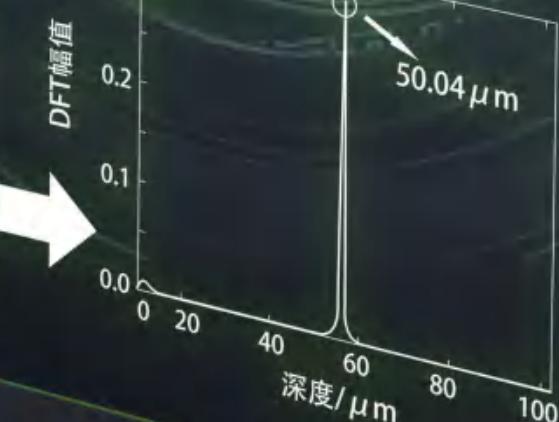
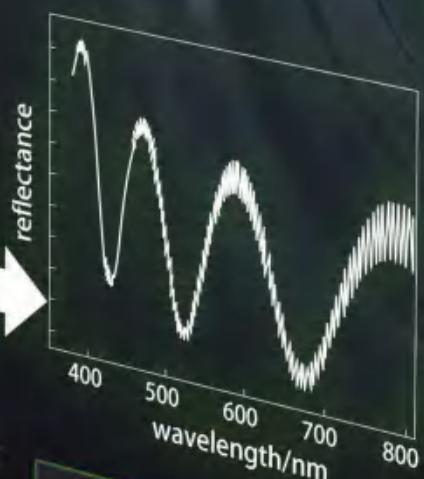
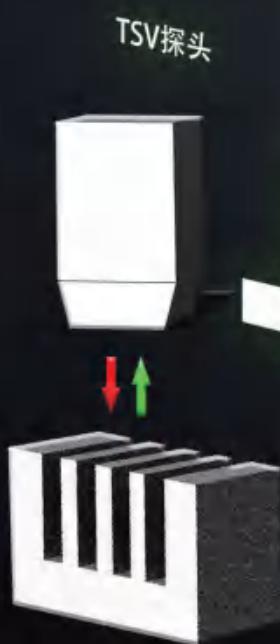
# 国内首款

<2 μm  
最小开口宽度

>300 μm  
最大测量深度

1:50  
最大深宽比

360° 1 μm  
最小分辨率



采用非接触式、非破坏性技术  
可测TSV、TGV等多种微孔槽结构



上海龙瞳智能科技有限公司

上海市徐汇区虹梅路街道宜州路188号华鑫惠享城B7栋11层

Tel: 13585572706 Email:info@lightek.cn 网站: www.LighTek.cn

LONG TONG ZHI NENG



客服咨询

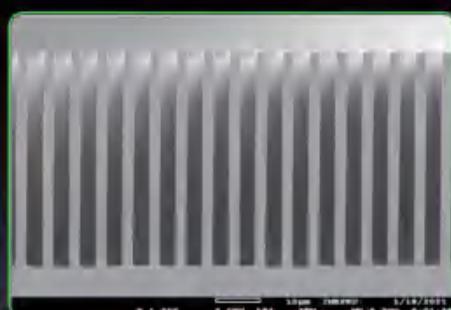


公众号

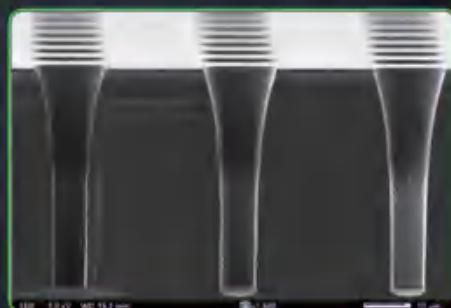
## 龙瞳智能

### ● 经典应用

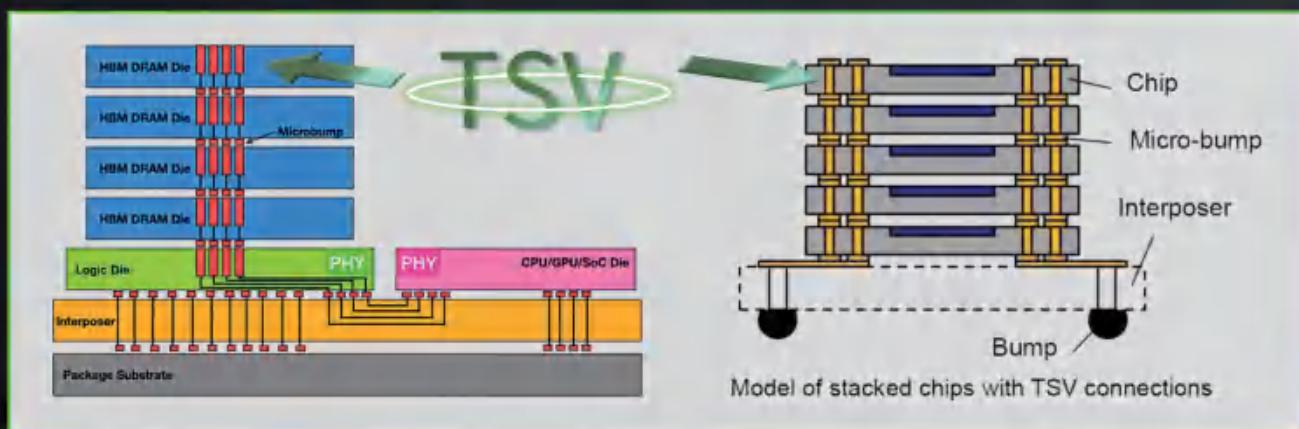
Tigris系列是一款专为高深宽比TSV检测设计的光学测量系统，采用非接触式、非破坏性技术，提供高效、精准的TSV深度测量解决方案，快速帮助半导体制造商发现缺陷，助力HPC和AI芯片的先进制程发展。



MENS典型高深度宽比结构



IC典型高深度宽比结构：TSV



### ● 技术参数

#### 产品参数

Tigris系列
测试类型
深度测量
光源类型
宽光谱光源
适配晶圆尺寸
8 英寸 (可选 12 英寸)
检测项目
TSV CD、阶高、晶圆厚度、三维可视化
TSV CD
$\varphi 3\text{--}20 \mu\text{m}$
最大深宽比
1:50
工作距离
40mm
镜头
5X,20X(或其他选择); 聚焦镜头
系统配置
XYZC (400x350x10mm, 360°) 1 μm 分辨率
洁净度等级
Class 100
核心探头尺寸
40*40*60cm

- 独特光学设计，提高检测精度
- 高效信号处理，提高检测速度
- 采用白光检测，降低检测成本
- 在线检测技术，提高生产效率